

債務保証先企業名及び保証プロジェクト

企業名	株式会社 テクノス
代表者 住所 電話番号 資本金・従業員 http E-mail	大野 亮平 大阪府枚方市長尾町1-32-1 072-867-6060 189百万円 、 33人 http://www.technos.co.jp/ salse@technos.co.jp
保証金額	24 百万円
プロジェクト名	「ナノ半導体をサポートする生産ライン対応 新型膜厚測定装置」の開発と事業化
プロジェクト 概要	次世代(配線ルール:90nm 以下)の半導体製造プロセスではバリア膜・低誘電率の層間絶縁膜など、様々な薄膜の採用が目される。現行技術では、それら 3~5nm の薄膜の測定は困難。本件は「蛍光X線光学系」と「反射率X線光学系」を組み合わせ、短時間で精度良く測定可能な装置を開発。成膜工程での歩留まり向上への寄与を目指す。

企業名	株式会社 エス・エフ・シー
代表者 住所 電話番号 資本金・従業員 http E-mail	小笠原 有美 横浜市中区日本大通 11 番地 横浜情報文化センター 12 階 045-681-0147 100百万円 、 57人 http://www.imagination.co.jp webmaster@yokohama-bunka.ne.jp
保証金額	24 百万円
プロジェクト名	高機能接着剤を使った石英構造物の製造工法開発と製品事業化
プロジェクト 概要	同社が開発した高機能接着剤(商品名「iシール」)は、石英同士の接着が可能である。さらに耐熱性、脱ガス、接着強度に優れている。従前の溶接により組立てている石英槽の加工方法が、「iシール」を用いることにより、飛躍的な生産性の向上が期待できる。また、溶接では行いにくい小さな石英構造物の組立も可能であり、新しい製品群の開発も期待できる。